



NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

*2013年1月31日にイスラエルで発表されたプレスリリースの抄訳です。

FleX™ Silicon-on-Polymerに、タワージャズCMOSプロセスを利用。

先進ファウンドリプロセスによって、標準シンコンウェハーを利用し、物理的柔軟度を有するフレキシブルICを生産

2013年1月31日 ボイジ、ニューポートビーチスペシャルティファウンドリの世界的リーダーであるタワージャズ (TowerJazz) がファウンドリとして初めて、CMOS プロセス (CS18) を利用し、FleX™ Silicon-on-Polymer™ を利用した柔軟なウェハーと集積回路 (IC) を提供すると、American Semiconductor, Inc は発表しました。この発表は、2013年1月29日から2月1日まで米国アリゾナ州フェニックスで開催された第12回フレキシブル&プリントドエレクトロニクス会議で行われました。

FleX Silicon-on-Polymer は、標準的なシリコンウェハーを、フレキシブルなウェハー (柔軟度を有し曲げることが可能なウェハー) へと変換する American Semiconductor のプロセスです。これにより、平坦でない表面に取付け、プリントドエレクトロニクス【プリンティング (印刷) 技術を活用し、電子回路/センサー/素子などを製造すること】に活用し、フレキシブルなハイブリッドシステムを作ることができます。「FleX は、様々なプロトタイプとプロセスを用い、デモを成功させました。CS18 プロセスを用いて FleX をリリースするという目標に向かってタワージャズと提携することは、フレキシブル IC を活用する可能性を広げます。このことは、フレキシブル・エレクトロニクス業界にとってもプラスとなります。」と American Semiconductor ゼネラルマネージャーの Rich Chaney 氏と述べています。

American Semiconductor 社は、Flex IC やフレキシブルなハイブリッドシステム開発に対して、完全にサポートを提供していきます。この一環として、CS18-Flex を含む全タワージャズ CMOS プロセスに対する IC デザインサポートを提供していきます。デザインサポートには、カスタム IC デザインに対するサポート、IP 開発・統合に対するサポート、顧客がサポートを必要とする可能性があるデザインフローに対するデザインサポートが包含されます。また、フレキシブルなハイブリッドシステムに対するエンジニ

アリングサポートの一環として、プリンテッドエレクトロニクスデザイン、製造、Flex インテグレーション、プロトタイプ開発に対するサポートも提供していきます。

Flexは、フレキシブルなハイブリッドシステムの実現に必要なプリンテッドエレクトロニクスと互換性を有します。コンフォーマル(形状に合わせることができる)な構造上も統合可能なアンテナ、自動車や航空宇宙機の構造ヘルスマonitoring、フレキシブルな家庭用電化製品を含む多くのアプリケーションで新しいイノベーションを可能にします。

アメリカンセミコンダクタについて

American Semiconductor, Incは、フレキシブルな集積回路とフレキシブルなハイブリッドシステム開発、フレキシブルIC生産向けサービスプロバイダーの業界のリーダーです。ITAR準拠したフレキシブルな製品・サービスプロバイダーとして、American Semiconductorは、フレキシブルデザイン・プロセッシングの全側面をサポートします。サービスは、Flex™ Silicon-on-Polymer™ 技術、デザイン、検証、レイアウト、テストを含む、デザインエンジニアを含みます。www.americansemi.com.にアクセスしてください。

American Semiconductor Inc.、American Semiconductor ロゴ、Flex, Silicon-on-Polymerは、American Semiconductor, Inc. の商標です。

タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE: TSEM)は、米国にある完全子会社ジャズセミコンダクター社、日本にある完全子会社タワージャズジャパン株式会社とともに、タワージャズというブランド名でグローバルに事業展開するスペシャルティファンドリのリーダーです。タワージャズは 1.0 から 0.13 ミクロンのプロセスノードで集積回路を生産し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル、RFCMOS、CMOS イメージセンサ、パワーマネージメント (BCD)、不揮発性メモリ(NVM)、CMOS、MEMS など、幅広いカスタマイズが可能なプロセス技術を提供しています。また洗練された技術で迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインインフラメントプラットフォームも提供します。さらに、IDM やキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業、R&Dから生産を進める企業向けの Technology Optimization Process Service(TOPS)も提供します。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワージャズは 3 大陸にまたがり生産拠点を有することでグローバルなキャパシティを確保しており、イスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国と日本に各 1 か所(200mm)のファブに加え、中国の生産施設ともパートナーシップを提携しています。詳細は www.towerjazz.com をご覧ください。

American Semiconductor Contact: Rich Chaney | +1 208-336-2773 | richchaney@americansemi.com

TowerJazz Media Contact: Lauri Julian | +1 949 435 8181 | lauri.julian@towerjazz.com

TowerJazz Investor Relations Contact: Noit Levi | +972-4-604-7066 | noit.levi@towerjazz.com